

### 天圣制药集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保变更抵押物的公告

公告编号:2026-009

一、为全资子公司提供担保情况概述

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开的第六届董事会第十一次会议及2025年7月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司重庆天圣医药销售有限公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司天圣制药集团重庆有限公司(以下简称“天圣重庆”)为全资子公司重庆天圣医药销售有限公司(以下简称“天圣销售”)向银行申请授信提供担保事项。具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

在上述审议的授信额度内,天圣销售与重庆银行股份有限公司江华支行(简称“重庆银行江华支行”)签订了《流动资金借款合同》,贷款金额为500万元。公司为天圣销售该笔贷款提供连带责任保证担保及抵押担保,同时,天圣重庆为天圣销售该笔贷款提供抵押担保。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

二、本次变更抵押物的具体情况

为优化融资方案以及满足重庆银行江华支行授信业务的要求,经与重庆银行江华支行

### 深圳英飞拓科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

公告编号:2026-010

以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-004)。

二、本次变更抵押物对公司的影响

公司本次变更抵押物为全资子公司提供担保事项风险可控,符合公司日常业务经营的需要,不涉及新增担保事项,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司 董事会 2026年3月11日

### 东风汽车股份有限公司关于控股股东权益变动暨控股股东拟被吸收合并的进展公告

公告编号:2026-013

一、控股股东权益变动暨本次吸收合并进展

2026年3月9日,东风集团股份召开临时股东大会及H股类别股东大会,会议审议通过关于东风汽车以吸收合并方式将东风集团股份私有化等特别决议案。具体内容详见东风公司、东风投资、东风集团股份于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)联合发布的《联合公告披露》(以下简称“联合公告”)。

二、本次吸收合并的进展公告

三、其他说明

截至本公告披露日,本次吸收合并的实施条件仍待达成/豁免,能否最终实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。本公司将持续关注本次吸收合并的后续进展情况,并严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注本公司后续公告。

东风汽车股份有限公司 董事会 2026年3月12日

### 关于工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2026年3月12日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
基金代码	工银瑞信1000增强股票
基金主代码	019092
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规及本基金合同法律法规等。
基金管理人类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘子豪
原任基金经理姓名	杨文

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘子豪
任职日期	2026年3月10日
证券从业资格	是
基金从业资格	是
过往从业经历	曾任安信证券量化研究员,2022年加入工银瑞信,现任权益及量化投资组合经理。

其中,管理过公募基金产品的名称及期间

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
010908	工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	2023年4月12日	
014133	工银瑞信中证500六个月持有期增强型股票证券投资基金	2024年6月16日	
961289	工银瑞信中证1000增强股票交易型开放式指数证券投资基金	2024年6月14日	
150543	工银瑞信中证2000交易型开放式指数证券投资基金	2024年8月14日	
510630	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2024年2月27日	
164809	工银瑞信中证1000指数证券投资基金(L2P)	2024年2月27日	
160224	工银瑞信中证1000指数增强股票证券投资基金	2025年2月27日	
150549	工银瑞信中证A500增强股票交易型开放式指数证券投资基金	2025年6月20日	
150227	工银瑞信中证港股通高股息行业交易型开放式指数证券投资基金	2025年7月14日	
012740	工银瑞信中证港股通高股息行业交易型开放式指数证券投资基金	2023年11月30日	2024年11月28日

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否

是否因基金业务违法违规被监管机构采取行政监管措施 是

取得的其他相关从业资格 中国

学历、学位 硕士研究生

是否已按规定在中国基金业协会登记/备案 是

工银瑞信基金管理有限公司 2026年3月12日

### 广发基金管理有限公司关于广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年3月12日

1. 公告基本信息

基金名称	广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	广发中证红利ETF联接式基金
基金代码	001399
基金管理人名称	广发基金管理有限公司

公告依据:《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金招募说明书》

暂停相关业务的时间、金额及限制说明:自2026年3月12日起,暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务,单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金合计超过100,000.00元的大额申购。即机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元,则100,000.00元确认成功,超过100,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多次累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的金额大于100,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累计加上100,000.00元的申请确认成功,其余超出部分申请金额本公司有权确认失败。

2. 其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年3月12日起,广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)暂停机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金合计超过100,000.00元的大额申购。即机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元,则100,000.00元确认成功,超过100,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多次累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的金额大于100,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累计加上100,000.00元的申请确认成功,其余超出部分申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将合并计算,不同销售渠道的申购将分别计算,并按上述规则进行确认。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线9516828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffund.com.cn获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等相关法律文件。

广发基金管理有限公司 2026年3月12日

### 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年03月12日

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年03月16日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

3.1 本次分红权益登记日:已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核。

3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择,未选择分红方式的,默认采取现金分红。

3.4 投资者可通过本基金管理人客户服务电话和各销售机构查询当前的分红方式。如需修改分红方式的,需在权益登记日前一工作日交易时间结束前向销售机构办理变更手续,最终分红方式以本基金注册登记机构确认的分红方式为准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需向各销售机构逐一提交分红方式变更申请。

3.5 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额(1.00元)时,注册登记机构将投资者的现金红利扣除股息日除息后的基金份额净值自转为基金份额。

3.6 咨询方式

(1) 本基金管理人网站:www.thfund.com.cn; 客户服务电话:400-986-8888。(2) 销售服务机构:详见本基金官网列示。

风险提示

基金分红导致基金净值不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司 二〇二六年三月十二日

### 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于收到资产包转让款的进展公告

公告编号:2026-009

一、交易概述

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“杰恩设计”)于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议,2025年11月13日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,公司将全资子公司深圳市杰恩创意设计有限公司(以下简称“杰恩创意”)100%股权以现金方式出售给峰先先生,以上股东委峰先先生;在完工工商变更等相关条件符合后,公司将与设计业务相关的资产包以现金方式出售给峰先先生控制的杰恩建筑。具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-061)。

二、交易进展情况

本次交易出售的设计业务相关的资产包负债净额为19,844.32万元。转让时各方签订的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设计业务资产包之附生效条件的转让协议》约定采用分期付款的方式,杰恩建筑分五期向公司支付转让款:

(1) 在协议生效且杰恩建筑工商变更完成后10个工作日内,杰恩建筑应向公司支付第一笔转让款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰陆拾陆元);

(2) 在杰恩建筑工商变更完成后6个月内,杰恩建筑应向公司支付第二笔转让价款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰陆元);

(3) 在杰恩建筑工商变更完成后12个月内,杰恩建筑应向公司支付第三笔转让价款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰陆元);

(4) 在杰恩建筑工商变更完成后18个月内,杰恩建筑应向公司支付第四笔转让价款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰陆元);

(5) 在杰恩建筑工商变更完成后24个月内,杰恩建筑应一次性向公司支付剩余转让对价,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰陆元)。

公司于2025年11月18日完成杰恩建筑100%股权交割,2025年12月4日完成资产包交割,2026年3月10日收到杰恩建筑支付的资产包转让款3,968.86万元,第二期资产包转让款已全部支付。

三、其他说明

公司将根据后续收到设计业务资产包转让款情况持续进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2026年3月11日

### 广州方邦电子股份有限公司关于自愿性披露子公司对外投资的公告

公告编号:2026-007

一、对外投资的基本情况

(一)对外投资的基本情况

1. 相关风险提示:目标公司的实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争不确定风险,存在一定的市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。本次投资不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。

2. 对外投资的基本情况

(一)目标公司的基本情况

统一社会信用代码	914403001019632630
成立日期	2014/10/29
注册地址	深圳市宝安区观澜街道观澜社区观澜路1310号附24501
法定代表人	1,063,260967万元
注册资本	1,063,260967万元

(二)目标公司的股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
四方合(深圳)投资管理合伙企业(有限合伙)	233,9784	22.142%
吴晨	121.2	11.607%
又马希远创业一期股权投资合伙企业(有限合伙)	89,3071	8.4794%
又马希远创业二期股权投资合伙企业(有限合伙)	56,4361	5.380%
广南半导体投资有限公司	54,5453	5.1767%
广东省号母及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	47,7196	4.537%
广南泰新股权投资合伙企业(有限合伙)	41,3908	3.9113%
广南华创股权投资合伙企业(有限合伙)	36,3056	3.321%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	32,1129	3.048%
北京中微国际股权投资合伙企业(有限合伙)	31,4815	2.980%
四方合(厦门)投资管理合伙企业(有限合伙)	30,1336	2.810%
广南华创股权投资合伙企业(有限合伙)	26,8907	2.491%
广南华创股权投资合伙企业(有限合伙)	20,1711	1.912%
合创中管智能汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)	19,2678	1.825%
北京中微国际股权投资合伙企业(有限合伙)	16,0389	1.528%
北京中微国际股权投资中心(有限合伙)	11,2568	1.068%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	10,6999	1.012%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	7,828	0.738%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	6,2322	0.587%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	6,2322	0.587%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	5,9463	0.560%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	5,9463	0.560%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	0,1133	0.011%
北京中微国际股权投资中心(有限合伙)	0,0536	0.005%
合计	1,063,26096	100.000%

二、投资标的的基本情况

(一)目标公司的基本情况

统一社会信用代码	914403001019632630
成立日期	2014/10/29
注册地址	深圳市宝安区观澜街道观澜社区观澜路1310号附24501
法定代表人	1,063,260967万元
注册资本	1,063,260967万元

(二)目标公司的股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
四方合(深圳)投资管理合伙企业(有限合伙)	233,9784	22.142%
吴晨	121.2	11.607%
又马希远创业一期股权投资合伙企业(有限合伙)	89,3071	8.4794%
又马希远创业二期股权投资合伙企业(有限合伙)	56,4361	5.380%
广南半导体投资有限公司	54,5453	5.1767%
广东省号母及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	47,7196	4.537%
广南泰新股权投资合伙企业(有限合伙)	41,3908	3.9113%
广南华创股权投资合伙企业(有限合伙)	36,3056	3.321%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	32,1129	3.048%
北京中微国际股权投资合伙企业(有限合伙)	31,4815	2.980%
四方合(厦门)投资管理合伙企业(有限合伙)	30,1336	2.810%
广南华创股权投资合伙企业(有限合伙)	26,8907	2.491%
广南华创股权投资合伙企业(有限合伙)	20,1711	1.912%
合创中管智能汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)	19,2678	1.825%
北京中微国际股权投资合伙企业(有限合伙)	16,0389	1.528%
北京中微国际股权投资中心(有限合伙)	11,2568	1.068%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	10,6999	1.012%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	7,828	0.738%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	6,2322	0.587%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	6,2322	0.587%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	5,9463	0.560%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	5,9463	0.560%
嘉禾天祥股权投资合伙企业(有限合伙)	0,1133	0.011%
北京中微国际股权投资中心(有限合伙)	0,0536	0.005%
合计	1,063,26096	100.000%

三、投资方式

方邦电子拟以自有资金2,000万元收购清石晶持有的中科四合1,063659%股权(对应注册资本1,256508万元),本次交易完成后,方邦电子对中科四合的持股比例为1,063659%,中科四合将成为公司全资子公司方邦电子的参股公司。

四、股权转让的主要内容

甲方(转让方):苏州清石晶磊股权投资合伙企业(有限合伙)

乙方(受让方):广州方邦电子有限公司

丙方(目标公司):深圳中科四合科技有限公司

本协议各方协商一致,转让方将其持有目标公司注册资本1,256508万元以2,000万元的价格转让给受让方。

转让方确认和承诺:1)转让方对标的股权拥有真实、完全和合法的所有权,转让方已按时足额履行标的股权所对应的全部缴款义务,受让方对标的股权不再有任何出资义务;(2)标的股权不存在质押、被查封或冻结等任何权利负担以及可能影响受让方对标的股权所有权的现实或潜在的诉讼、仲裁、行政处罚等事项。

目标公司应协助并促使目标公司其他股东协助受让方完成本次股权转让有关的手续,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、对外投资对上市公司的影响

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

七、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

八、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

九、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十一、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十二、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十三、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十四、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十五、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十六、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十七、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十八、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

十九、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

二十、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

二十一、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

二十二、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略协同性,是先进芯片封装的关键基础设施,目标公司作为先进封装企业,有利于增强使用需求,在芯片封装产业链各环节实现协同。通过加强与目标公司的合作,对于整合双方产业资源,加大双方封装产品的研发力度,提升市场竞争力,从而提升公司运营效率和核心竞争力。

本次对外投资投资标的具有自主知识产权,是在保证自主可控的前提下作出的投资决策,不会对本次财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

二十三、对外投资的风险提示

目标公司本次投资中,公司进一步完善和提升产业布局的举措,符合公司总体发展战略要求,对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产平板封装(PLP)领军企业,PLP是下一代先进封装技术,可容纳更大尺寸芯片并支持业务拓展,支持超大规模、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的晶圆封装集成,较当前主流WLP(Wafer Level Packaging)技术可容纳更多封装层,提升信号传输损耗与寄生电容,提升信号完整性与高频性能,降低器件功耗,适配下一代高性能、高性能AI芯片的异构集成需求。

目标公司本次投资具有明确的协同性,可增强公司的战略